

证券代码：601231
转债代码：113045

证券简称：环旭电子
转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司 2022 年年度业绩说明会活动记录

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
时间	2023 年 4 月 18 日
地点	同花顺路演平台 https://board.10jqka.com.cn/rs/
上市公司 参会人员	陈昌益（董事长）、储一昀（独立董事）、史金鹏（董事会秘书）、刘丹阳（财务总监）
业绩说明会文字互动环节记录	<p>【问题】公司的 SiP 模组业务市场份额怎么样？</p> <p>【回答】公司的占比最高的产品为通讯类产品及消费电子类，主要包括 Wi-Fi 模组、UWB 模组、5G 毫米波 AiP 模组、智能手表模组、TWS 模组等，公司是 SiP 模组领域的龙头厂商，在公司主要客户的 SiP 模组领域占有优势的竞争地位，SiP 模组出货量位居全球第一。</p> <p>【问题】请董事长介绍一下公司文化，践行文化的重点，还有公司要成为一个什么样的公司</p> <p>【回答】公司始终以“成为全球电子设计制造服务最靠谱的厂商”为愿景，围绕着模组化、全球化、多元化的发展策略，成为全球行业内更领先的龙头企业。长期以来，环旭电子坚持以永续经营为目标，不断提高公司治理和投资者关系管理水平，在资本市场树立良好的企业形象，持续提升企业的社会价值。与此同时，我们不仅尊重和保障员工权利，全力打造安全友好的职场环境，还十分重视与合作伙伴、上下游产业链及投资者的相互关系，协同利益相关方，建立可持续发展的伙伴关系，通过合作创新持续推动价值链成长，助力社会健康发展。未来，环旭电子将不忘初心，切实践行低碳使命、循环再生、社会共融、价值共创，以可持</p>

续发展为目标，实现高质量增长。

【问题】公司在 5G、6G 方面有什么业务吗？

【回答】公司积极关注通讯技术的发展及迭代，当前为大客户供货 5G 毫米波天线模组。业界预计 6G 网络进入商用要到 2030 年前后，无线通讯相关的 SiP 模组产品在 6G 时代有望得到更广泛的应用。

【问题】锡料涨价对公司成本是否有影响，影响大不大？

【回答】基础原材料的价格波动，一般不直接影响公司原材料采购成本；公司原材料的采购成本主要受 IC、基板、被动元件等价格变动的影响。根据行业惯例，公司发生的与服务客户相关的主要成本和费用发生显著变化时，公司可以按照合同或订单的约定，与客户协商调整产品及服务价格，以保证公司取得合理的制造服务利润。

【问题】公司和服务器算力相关的业务占比如何？

【回答】公司 2022 年“云端及存储类”业务约占公司营收总额的 10%，其中主要产品包括服务器主机板、高速交换机主机板、企业级 SSD 产品等，均可用于人工智能、边缘计算、云计算、数据中心等领域的核心设备。

【问题】公司股票在二级市场估值持续低迷 是否有系统计划如何提振投资者信心？

【回答】公司管理层除认真经营实现业绩持续成长外，同样重视投资人利益保护，如有提振股价的措施将及时公告。

【问题】请问董事长，公司有做 chiplet 吗？和公司做的 sip 有什么区别？

【回答】SiP (system in package) 指系统级封装，是通过高密度表面贴装、灵活多样的封装和电磁屏蔽，把诸如应用处理器、存储器、FPGA、电源管理、无线传输、MEMS、音频和光学传感器、生物识别模块等多个功能芯片、电子器件集成在一个基板 (Substrate) 上，构成一个满足客制化要求的高集成度的微小化系统。Chiplet (芯粒) 是把一些特定功能的芯片裸晶，通过芯片级先进封装技术，实现多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起，形成一个系统芯片。因此，Chiplet 还是芯片，SiP 是微小化系统，两者在功能和用途上存在差异。公司

重点发展 SiP 模组相关的异构封装技术，和芯片级封装技术也有所不同。

【问题】请问贵公司龙头产品市场占有率怎么样？苹果链是否继续深度合作，23 年公司主要的经营方向是什么？

【回答】因与客户签署保密协议，公司不对具体客户份额情况评论。如同今天简报中介绍的情况所述，公司在手机、平板的无线 SiP 模组及手表、耳机的 SiP 模组出货总量为全球第一。

【问题】公司有 AI 的业务吗？

【回答】公司未直接从事与 AI 相关的业务。公司云端及存储类产品业务线，为客户提供服务器主机板、高速交换机主机板等设计制造服务，可应用于云计算、数据中心、边缘计算、人工智能等领域的相关设备中。

【问题】MR 产品里面有没有涉及到 SIP 封装技术？

【回答】公司正在与公司的客户合作开发 XR 相关产品的无线通信与系统级模块，2022 年有少量相关收入产生。

【问题】公司在 MR 方面有哪些布局啊？

【回答】公司正在与公司的客户合作开发 XR 相关产品的无线通信与系统级模块，2022 年有少量相关收入产生。

【问题】公司有哪些电动车业务的客户？新能源车有哪些国内客户？

【回答】公司的新能源汽车相关的汽车电子业务，主要服务于欧美日的 IDM 厂商、Tier 1 厂商、整车厂。比较有代表性的客户包括 Infineon、Hitachi、WolfSpeed、Magna、Borg Warner 等。随着汽车电动化的趋势愈发明确，公司汽车电子客群构成中新能源车的占比将快速提升。汽车电子，尤其是新能源车相关的汽车电子业务，是公司的重点发展方向之一，公司目前已开始向多家新能源车厂商提供车电产品。国内是新能源汽车的重要市场，公司重视业务机会的拓展。

【问题】公司的股东数量有多少？

【回答】公司已在 2022 年年度报告中披露，截至 2023 年 3 月末，公司股东人数为 40,272 人。

【问题】请问公司 5G 毫米波产品什么时候能较大幅度的成长？

【回答】如果公司重要客户未来智能手机毫米波频段手机携带率显着提升，或应用在更多的硬件设备中，将带动公司 5G 毫米波模组较快增长。

【问题】WiFi7 有什么特点？公司为什么看好 WiFi7？

【回答】公司未来将配合客户开发 Wi-Fi 7 相关通讯模组。Wi-Fi 7 是下一代 Wi-Fi 标准，也称为 IEEE 802.11be。它是 Wi-Fi 6 的后继者，提供了更快的速度和更低的延迟。Wi-Fi 7 使用 2.4GHz、5GHz 和 6GHz 的频段，最高速度可达 46 Gbps。Wi-Fi 7 的主要改进包括更好的多用户多输入多输出（MU-MIMO）技术、更好的信道利用率、更好的功率管理和更好的安全性。

【问题】请问公司在人工智能 AI 和边缘计算、云计算这些领域有哪些类产品或技术布局呢？

【回答】公司代工制造的服务器主机板、高速交换机主机板、企业级 SSD 产品等均可用于边缘计算、云计算、数据中心等领域的核心设备。今年 1 月公司也协助客户推出了最先进的边缘 AI 服务器，这是一款 2U 机架式边缘 AI 服务器，采用 Intel 第三代 Xeon Platinum 处理器，配备四路单槽宽或两路双槽宽 NVIDIA GPU，公司为客户提供了全套的架构和概念设计，包括机箱设计、硬件、固件设计（交换机固件，BIOS 和 BMC 固件）以及散热设计，该款服务器可支持户外电信箱、计算机房、工厂、商店等众多应用场景。

【问题】公司的功率模组未来是否应用到光伏、风电领域？

【回答】公司目前量产和研发的功率模组主要应用在电动汽车中，未来也有机会应用于储能、工业类产品上。

【问题】已投资环旭 6 年，虽然环旭在二级市场表现一般，但是无论是经营业绩、公司治理还有战略眼光都是很优秀的，我将继续支持环旭，也请公司管理层继续加油！

【回答】感谢投资者对公司长期以来的支持与新任，公司将继续秉承自身的战略发展方向，不断进步，持续为股东创造价值。

	<p>【问题】毫米波产品前景？继工信部新增了毫米波频段后，全国首张 E 波段(毫米波段)微波电台执照近期颁发。随着未来毫米波频段使用许可的发放。预计会给公司毫米波产品带来多少增量？</p> <p>【回答】公司目前出货的 5G 毫米波模组应用于大客户的智能手机中，当前全球各个国家在毫米波波段的 5G 通讯基建方面均有普通程度的进展，相信未来随着全球各个国家地区的毫米波通讯基建的铺设、普及，有助于公司毫米波模组业务的持续成长。</p> <p>【问题】请问公司目前有向国内的新能源车供货汽车电子产品吗，谢谢</p> <p>【回答】随着汽车电动化的趋势愈发明确，公司汽车电子客群构成中新能源车的占比将快速提升。汽车电子，尤其是新能源车相关的汽车电子业务，是公司的重点发展方向之一，公司目前已开始向多个欧美日的客户提供新能源相关的车电产品。国内是新能源汽车的重要市场，公司重视未来业务机会的拓展。</p> <p>【问题】公司是否有计划在印度投资设点？</p> <p>【回答】公司的越南厂已量产用于智能手表的 SiP 模组，可根据客户订单和产能配置需求量产其他 SiP 模组，公司通过全球化布局产能和运营，具备应对产业链转移的灵活性和经营“韧性”，公司在全球的 28 个生产据点，能持续满足客户的在地化生产需求。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 4 月 18 日